

安信证券股份有限公司
关于深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

二〇二二年五月

声 明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”“保荐人”或“保荐机构”）接受深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“深科达”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构。

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”或“贵所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

一、发行人概况

（一）发行人简介

中文名称：深圳市深科达智能装备股份有限公司

英文名称：Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co.,Ltd.

注册地址：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：深科达

股票代码：688328

成立日期：2004年6月14日

法定代表人：黄奕宏

注册资本：8,104.00 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：机器视觉产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的研发、生产和销售；电子半导体工业自动化设备、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售；直线机器人产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售。

（二）主营业务

公司是一家智能装备制造商，主要产品为应用于平板显示器件、半导体、摄像头等领域的各类专用组装及检测设备，并向智能装备关键零部件领域进行了延伸。

公司自成立以来，秉承“成为装备领域更具价值的企业”的愿景，积累了深厚的技术储备和丰富的项目经验，具备将客户需求快速转化为设计方案和产品的

业务能力，树立了良好的市场形象和品牌知名度；在平板显示领域，与天马微电子、华星光电、业成科技、华为、京东方、维信诺、友达光电、伯恩光学、蓝思科技、欧菲光等知名企业建立了合作关系；在半导体封装测试领域，与扬杰科技、华天科技、通富微电、山东晶导微电子股份有限公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司等企业建立了合作关系，累计积累了众多优质客户群体。

公司的产品可以分为平板显示模组设备、半导体设备、直线电机和摄像模组类设备。报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-3月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
平板显示模组设备	4,540.85	27.76%	51,598.07	56.77%	43,604.00	67.73%	35,475.67	75.36%
半导体设备	7,995.34	48.87%	27,736.02	30.52%	12,051.82	18.72%	3,992.99	8.48%
直线电机	2,168.45	13.26%	6,434.62	7.08%	4,600.36	7.15%	2,329.27	4.95%
摄像模组类设备	1,212.04	7.41%	1,937.57	2.13%	1,350.92	2.10%	3,330.74	7.08%
其他	442.20	2.70%	3,182.67	3.50%	2,773.89	4.31%	1,943.96	4.13%
合计	16,358.88	100.00%	90,888.96	100.00%	64,380.99	100.00%	47,072.64	100.00%

1、平板显示模组设备

平板显示模组类设备主要用于完成平板显示器件后段制程的组装和检测，是公司的主要产品，报告期内累计实现的收入占主营业务收入比例达 **61.83%**。按照产品实现的功能与作用，可细分为以下几类：

(1) 贴合类设备

公司贴合系列产品主要用于完成 LCD/OLED/Mini-LED 平板显示器件后段制程中的精密贴合工序，其中包括偏光片贴附、触控 Sensor 贴合、OCA 全贴合、指纹模组贴合、3D 曲面贴合等。贴合类设备除包含核心的软对硬贴合和硬对硬真空贴合外，通常还整合了自动上下料、无尘布清洁、精度检测、UV 固化、脱泡等功能模块，可以根据客户需求，提供适用不同工序和特定性能参数的定制化产品，具有高度自动化、高精度、高良率、高稳定性的优点，主要产品如下：

产品名称	应用场景	技术指标	产品示例
------	------	------	------

<p>小尺寸 LCD 全贴 合设备</p>	<p>主要用于 1-8 英寸智能穿戴、手机等产品领域，使用 OCA 光学胶将显示屏与盖板贴合。</p>	<p>精度：±0.05mm 节拍：3.5S/PCS</p>	
<p>中尺寸 LCD 全贴 合设备</p>	<p>主要用于 7-20.3 寸车载、工业控制、平板电脑显示、笔记本电脑等领域，使用 OCA 光学胶将显示屏与盖板贴合。</p>	<p>精度：±0.1mm 节拍： 8-15S/PCS</p>	
<p>大尺寸 LCD 偏光 片贴合设备</p>	<p>主要用于 32-85 英寸 LCD 正反面的偏光板、增亮膜及增黑膜等贴合工艺流程。</p>	<p>精度：±0.2mm 节拍： 15-30S/PCS</p>	
<p>OLED 偏光 片贴合设备</p>	<p>主要用于 1-12 英寸智能穿戴、手机(含折叠手机)等产品领域的偏光板与 AMOLED 基板贴合。</p>	<p>精度：±0.05mm 节拍：4.5S/PCS</p>	

<p>OLED 触控 贴合设备</p>	<p>主要用于 1-12 英寸智能穿戴、手机(含折叠手机)等产品领域,使用 OCA 光学胶将触控面板与 AMOLED 基板贴合。</p>	<p>精度: $\pm 0.05\text{mm}$ 节拍: 4.5S/PCS</p>	
<p>OLED 曲面 贴合设备</p>	<p>主要用于 1-12 英寸智能穿戴、手机(含折叠手机)、平板电脑等产品领域,使用 OCA 光学胶将 AMOLED 基板与 3D 盖板贴合。</p>	<p>平面贴合精度: $\pm 0.05\text{mm}$ 曲面贴合精度: $\pm 0.1\text{mm}$ 节拍: 4.5-22S/PCS</p>	
<p>AMOLED 屏下指纹贴 合设备</p>	<p>主要用于 1-12 英寸手机、穿戴、平板等领域 AMOLED 显示屏的屏下指纹模组的贴合。</p>	<p>精度: $\pm 0.08\text{mm}$ 节拍: 4.0S/PCS</p>	
<p>AMOLED 曲面覆膜设 备</p>	<p>主要用于 1-8 英寸玻璃盖板(2D、2.5D、3D)/AMOLED 的制程膜、出货保护膜等卷状类膜材产品贴合。</p>	<p>精度: $\pm 0.1\text{mm}$ 节拍: 3.5-4.5S/PCS</p>	

<p>电子纸贴合设备</p>	<p>主要用 1.54-13.3 英寸电子书、电子价格标签、电子看板、电子标签等显示屏贴合。</p>	<p>贴合精度： ±0.1mm 节拍： 3.5S-8S/PCS</p>	
----------------	--	---	--

(2) 邦定设备

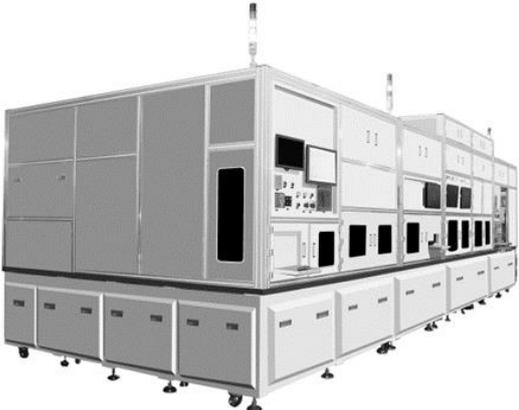
公司邦定系列产品主要包含两类：一类是用于完成显示模组生产过程中驱动芯片、柔性电路板与显示面板的热压邦定；另外一类为指纹识别模组组装设备，是公司顺应平板显示全面屏化的趋势，针对屏下超声波及光学指纹的市场新需求开发出的产品。公司邦定设备主要包括如下产品：

产品名称	应用场景	技术指标	产品示例
<p>全自动邦定设备</p>	<p>通过恒温、脉冲、激光等加热方式为手机、TV、车载中控、智能穿戴、PCB板等产品进行COG、FOG、COF、FOP邦定。</p>	<p>COG 精度： ±0.004mm FOG 精度： ±0.012mm COF 精度： ±0.012mm FOP 精度： ±0.012mm 节拍： 3.5-4.5S/PCS</p>	
<p>屏下指纹邦定自动线</p>	<p>针对屏下指纹超声波工艺设计，可实现产品清洁、邦定、AOI、点胶、上下料全自动化作业。</p>	<p>邦定精度： ±0.015mm 节拍：4S/PCS</p>	

(3) 检测设备

检测设备主要应用于 CG 外观、OLED 显示模组、LCD 液晶显示模组、Mini-Led 显示模组、Cell 段的外观、精度、点灯画面检测，运用机器视觉技术、数字化图像处理技术和自动化技术，精确并高效检测触控层、面板层、偏光片层、背光层的特定类型缺陷。公司检测设备主要包括如下产品：

产品名称	应用场景	技术指标	产品示例
全自动 Cell 缺陷点灯检测机	主要用于 3-8 英寸的 TFT-LCD 成盒后二切所得单粒产品在投入偏光片贴附前/后的检测。检测产品的点类、线类、影像类、Mura 类和色偏类等缺陷。	TT \leq 3.5S/PCS 漏检 \leq 0.5% 过检 \leq 8%	
全自动模组缺陷点灯检测机	主要用于 3-8 英寸 LCM 部分检测作业。检测产品的点类、线类、影像类、Mura 类和色偏类等缺陷。	TT \leq 3.5S/PCS 漏检 \leq 0.5% 过检 \leq 8%	
全自动外观缺陷检查机	主要用于显示模组外观检测，通过线扫描相机取像，经由预先设定好的限度参数细项对比，检测产品的崩边、崩角、刮伤划痕、气泡、油墨区缺墨等缺陷。	TT \leq 3.5S/PCS 漏检 \leq 0.5% 过检 \leq 8%	

<p>OLED AMT 全自动点灯检测机</p>	<p>主要用于通过色彩分析仪实现 pre-gamma 工艺;通过高像素全画幅相机实现 pre-gamma 后不断电的 AOI 检测。</p>	<p>TT≤4S/PCS 漏检≤0.5% 过检≤8%</p>	
<p>OLED AFT 全自动点灯检测机</p>	<p>主要用于 3-8 英寸 LCM/LAM 部分检测作业。检测产品的点类、线类、影像类、Mura 类和色偏类等缺陷。</p>	<p>TT≤4S/PCS 漏检≤0.5% 过检≤8%</p>	
<p>Fine pitch 全自动点灯检测机</p>	<p>主要用于 pitch≥30um、pad 宽度≥15um 的 7-17.3 英寸 CELL 点亮和检测。检测产品的点类、线类、影像类、Mura 类等不良。</p>	<p>点亮率≥99.6% 漏检率≤0.5% 过检率≤5%</p>	
<p>OTP/CTP 自动测试设备</p>	<p>主要用于显示屏 CELL/Module 段 /OLED 等全贴合前后的功能测试和 OTP 烧录。</p>	<p>FPC 压接良率≥99.6% 节拍: 3.5S/PCS</p>	

(4) 辅助设备

公司贴合、邦定和检测系列产品通常会整合多个不同的功能模块，以实现多功能一体化全自动组装与检测。为满足客户多样化的需求，公司也会单独生产销售上述功能模块的配套设备。公司辅助设备主要包括如下产品：

产品名称	应用场景	技术指标	产品示例
擦拭清洗机	主要用于平面 CG、2.5D 曲面 CG/TP 的清洗，可有效清除产品表面杂质、油污、吸盘印痕、毛线、残胶、小白点等异物，清洗后可进行贴合或者 AOI 检测。	清洗良率： >95% 节拍： 3.5S/PCS	
自动脱泡机	主要用于触摸屏和液晶显示模组生产工序中偏光片贴合、OCA 贴合以及全贴合后气泡的消除。	压力精度： $\pm 0.01\text{Mpa}$ 温控精度： $\pm 1.0^\circ\text{C}$ 内部温差： $\pm 3^\circ\text{C}$	
UV 固化机	主要用于 OCA、OCR 贴合产品或点 UV 胶产品的 UV 固化。	能量均匀度： > 90% UV 固化动态温度： $\leq 50^\circ\text{C}$	
自动上下料机	主要用于配合各种制程设备做在线式自动供料及收料。	分盘成功率： 100% 节拍：3.5S/PCS	

2、半导体类设备

产品名称	应用场景	技术指标	产品示例
测试分光机	全称发光二极管分光机，是发光二极管（又称 LED）在生产过程中必需的设备，用来对 LED 按照发出光的波长（颜色）、光强、电流电压大小进行分类筛选。	UPH: 60K 转盘吸嘴数量: 30 位 料盒: 20BIN	
测试分选机	主要用于分立器件、IC 器件的编带，整合打标系统和影像系统，具有高速测试打标编带能力。	UPH: 50K 机器稳定性: NTBA>60minutes; MTTA<30sec; MTBF>168Hours	

3、摄像模组类设备

摄像模组类设备主要用于摄像模组的封装和检测，其中影像模组自动组装线可实现全自动芯片贴合、贴合后快速固化、物料暂存、金线焊接、物料转运及调配、AOI 金线检测等一体化全自动运作。

4、直线电机系列产品

直线电机系列产品可以应用于大部分直线运动场合，是智能装备的基础动力元件，主要包括如下产品：

产品名称	应用场景	技术指标	产品示例
------	------	------	------

MIC 系列平板电机（有铁芯）	主要用于中小负载、高精度和高速度直线运动场合，具有体积小，推力大，推力脉动小的特点。	持续推力： 46N-435N 峰值推力： 1,700N	
DUM 系列 U 型电机（无铁芯）	主要用于高精度、高速度同时对体积要求较高的直线搬运场合。独有的一体化专利设计，带来较高的带负载能力，运动刚性、精度、速度优势明显，同时温升得到有效控制。	标准单体最大长度：6,000mm 重复精度： $\pm 1\mu\text{m}/500\text{mm}$	
E 系列经济型直线模组	可替代传统丝杠模组，技术指标优于丝杠 20%-30%，性价比高。	标准单体最大长度：4,000mm 重复精度： $\pm 3\mu\text{m}/500\text{mm}$	

（三）核心技术与研发水平

1、核心技术

截至报告期末，公司拥有的主要核心技术如下表所示：

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性说明	应用产品
1	精密视觉对位技术	自主创新	<p>①对位机构精度补偿：通过自动连续检测目标位置精度，建立对位机构的精度误差数据库，并使用动态补偿控制算法，减少对位机构安装及本身非线性误差；</p> <p>②高精度相机标定：采用自主设计的标定板及自主研发的相机自标定算法，实现高精度的识别，并对标定过程中数据实时拟合，动态反馈再调节实现精确标定，对位精度可达$\pm 3 \mu\text{m}$。</p>	贴合设备 邦定设备 检测设备 半导体设备 摄像模组设备 辅助设备
2	图像识别技术	自主创新	<p>①形状识别：可识别丰富的规则图形及不规则异形图形，其通过提取产品图像轮廓几何特征，自主选择轮廓特征进行自学习，建立该产品的特征模型，实时分析当前产品特征，自动计算最佳位姿，实现产品的精准识别定位；</p> <p>②图像分析：可动态分割图像中的背景及目标，提取特征数据，进行图像滤波、变换等预处理；对图像轮廓、灰度、相关性等特征分析，建立图像数据库，应用 AI 人工智能，深度学习并进行字符识别、产品检测及分类；</p> <p>③3D 视觉：利用激光及结构光等辅助扫描，对目标产品或空间进行 3D 重构，生成三维数据，对三维图像的数据进行分析处理，实现三维测量和定位、立体抓取，空间导航等应用。</p>	贴合设备 邦定设备 检测设备 半导体设备 摄像模组设备 辅助设备
3	机器人与视觉融合技术	自主创新	<p>①融合机器视觉与直角坐标机器人、四轴六轴机械手运动控制技术，构建基于 PC 的软件一体化，可实现坐标系统互换统一；</p> <p>②机器视觉为机器人提供与人眼类似的机器仿生系统，根据 2D 与 3D 视觉信号处理，引导机器人运动自动分拣、搬送、路径规划，并全程反馈控制机器人；</p> <p>③硬件级高速处理，集合了高速中断，位移传感器，旋转编码器等传感器，对视觉反馈的环境信息实时感知响应，实现高速动态控制。</p>	贴合设备 邦定设备 检测设备 摄像模组设备 辅助设备
4	压力精密控制技术	自主创新	此技术采用伺服电机结合低摩擦气缸，应用压力传感器实时反馈形成闭环控制，实现 1-50N 的低压力输出，其精度可达 $\pm 0.1\text{N}$ 。	贴合设备 邦定设备 检测设备 半导体设备

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性说明	应用产品
				摄像模组设备 辅助设备
5	胶量控制技术	自主创新	此技术是一种基于胶量自动量测并自动修正点胶量的技术。其利用胶量控制系统对当前点胶头的出胶量进行监控并自动进行误差分析，及时对出胶量做出调整，实现胶量精密控制至 $\pm 6\mu\text{L}$ 。	贴合设备 邦定设备 辅助设备
6	曲面仿形压合技术	自主创新	此技术使用 FEA 分析优化后的 PAD 将 AMOLED 与 CG 贴合，贴合过程中通过差补运动实时控制 AMOLED 的张力和 PAD 的反作用力，实现弧度 $\leq 90^\circ$ 双面/四面曲产品的高精度仿形贴合。	贴合设备
7	柔性屏高精度折弯技术	自主创新	此技术主要利用多轴机械手进行差补运动，实时控制柔性屏张力并将其折弯至与最终贴合曲率相匹配，实现折弯重复精度 $\pm 30\mu\text{m}$ 。	贴合设备
8	4 轴精度补偿技术	自主创新	此技术在传统 XY θ 补偿方式的基础上增加了 Z 向补偿，主要对折弯后的柔性屏进行精度确认及补偿，确保其能够精确的与 3D 玻璃完全匹配，提高贴合精度。	贴合设备
9	高精度贴合技术	自主创新	此技术采用四点中心对位方式，上下贴附平台在拍照位直接贴合，以保证修正后的位置不受影响，实现 $\pm 30\mu\text{m}$ 的贴合精度。	贴合设备
10	真空应用技术	自主创新	①真空控制：通过真空系统控制多组腔体，可在 5s 内使其真空值小于 10pa； ②真空平衡：主要应用于真空腔体内的真空治具，由于真空腔体在抽真空的过程中，腔体与治具形成逆向压差，治具上的产品易偏移和掉落，因此该技术通过设计关键阀门和管道使腔体与治具达到真空平衡，从而解决了该问题，提高了贴合精度和良率。	贴合设备
11	超大压力贴合技术	自主创新	此技术使用大压力输出机构，使 2000kgf 的压力作用在产品上，配合 FEA 分析优化后的一体式龙门垂直升降结构和自主设计的可承受大压力对位平台，实现大压力、高精度贴合，解决了产品出现水波纹的问题。	贴合设备
12	全自动贴合线整合技术	自主创新	此技术整合各个工位形成生产线，以达到全自动串联、降本增效的目的。主要工位包括：CG/TP 自动上料清洁、OCA 自动上料撕膜、CG/TP 与 OCA 贴合、LCM 自动上料清洁、LCM 点硅酮胶、CG/TP 与 LCM 贴合、自动脱泡、在线精度 AOI、在线气泡 AOI、UV 固化、成品自动下料。	贴合设备

序号	核心技术名称	技术来源	技术先进性说明	应用产品
13	PAD治具设计技术	自主创新	此技术以乙烯基和二氧化硅为原料，结合 FEA 设计制作 PAD，其表面经过特别工艺处理实现摩擦系数小于 0.1，降低了 PAD 与产品间摩擦力带来的不良影响。	贴合设备
14	Cover glass治具设计技术	自主创新	此技术采用高精度的三位一体治具，使其与 Cover Glass 精准匹配，减少了 Cover Glass 的裂片及贴合不良现象。	贴合设备
15	Fine pitch 高精度预压点亮技术	自主创新	此技术利用公司自主研发的高精度实时对位系统，使产品的最高对位精度提升到 $\pm 5 \mu\text{m}$ ，并采用闭环的位移压力控制系统，实现 $\pm 2\text{N}$ 的精确控制，达到在 $30 \mu\text{m pitch}$ 时 99%的点亮成功率。	检测设备
16	新型中小推力有铁芯永磁同步直线电机设计技术	自主创新	此技术主要解决在不损失电机效率的前提下尽可能降低推力波动的问题。一般技术在斜磁时推力波动才能控制在 $\pm 5\%$ ，且斜磁技术会导致电机效率降低 5%-15%，此技术可实现在无磁铁偏斜的情况下推力波动控制在 $\pm 3\%$ 以内，相对效率提升 10%左右，处于业内领先地位。	直线电机系列产品

2、研发投入

报告期内，公司研发投入及占营业收入的比例情况见下表：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
研发费用	1,913.87	7,444.34	6,076.95	4,762.40
营业收入	16,453.56	91,092.07	64,802.32	47,193.62
研发费用占比	11.63%	8.17%	9.38%	10.09%

3、研发人员情况

公司拥有业内资深技术人员组成的技术专家团队，构成公司技术研发的核心支柱力量。团队在机械、工艺、电气、软件、视觉等领域拥有深厚的技术积累，在产品开发上不断进行创新。公司技术研发贴近市场，结合市场需求进行专项开发。截至报告期末，公司拥有技术研发人员 207 人，占员工总人数的 22.14%。

（四）发行人最近三年及一期主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2022/3/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
资产合计	1,429,044,438.47	1,488,666,596.14	1,090,927,186.17	709,550,457.47
负债合计	596,353,192.96	673,695,154.33	606,503,963.22	309,860,861.46
所有者权益合计	832,691,245.51	814,971,441.81	484,423,222.95	399,689,596.01

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	164,535,638.06	910,920,747.11	648,023,211.21	471,936,166.13
营业利润	13,608,231.43	77,919,466.12	88,805,842.01	57,235,580.30
利润总额	13,449,959.64	77,088,208.54	89,163,396.45	55,640,856.21
净利润	11,957,817.62	75,063,133.52	82,873,626.94	52,739,189.95
归属于公司普通股股东的净利润	5,557,093.22	55,744,819.26	72,777,939.91	50,889,295.01

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,457,540.37	50,412,740.45	66,579,539.33	41,767,047.85

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-43,106,398.80	-83,740,262.75	17,631,544.60	13,700,845.26
投资活动产生的现金流量净额	-62,567,198.25	-158,160,883.53	-74,411,077.75	-28,590,607.23
筹资活动产生的现金流量净额	37,374,934.07	273,738,753.75	94,762,303.99	920,954.36
现金及现金等价物净增加额	-68,402,994.41	31,405,935.85	36,249,037.88	-14,057,601.49
期末现金及现金等价物余额	135,529,612.06	203,932,606.47	172,526,670.62	136,277,632.74

4、主要财务指标

财务指标	2022-3-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动比率（倍）	1.99	1.86	1.66	2.12
速动比率（倍）	1.50	1.44	1.21	1.60
资产负债率（合并）	41.73%	45.25%	55.60%	43.67%
资产负债率（母公司）	28.43%	30.37%	51.05%	41.84%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	9.50	9.43	7.57	6.37
财务指标	2022年1-3月	2021年度	2018年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	0.30	1.87	1.89	1.81
存货周转率（次/年）	0.45	2.55	1.97	1.87
息税折旧摊销前利润（万元）	1,696.50	9,007.56	9,810.87	6,141.41
利息保障倍数	13.97	15.76	38.67	41.78
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	555.71	5,574.48	7,277.79	5,088.93
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润（万元）	445.75	5,041.27	6,657.95	4,176.70
研发投入占营业收入的比例	11.63%	8.17%	9.38%	10.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.53	-1.03	0.29	0.23
每股净现金流量（元）	-0.84	0.39	0.60	-0.23

计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产－存货－预付账款－其他流动资产）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于公司普通股股东的净资产/期末普通股股份总数

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

总资产周转率=营业收入净额/平均资产总额

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入

5、公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2019年度	14.07%	0.84	0.84
	2020年度	17.18%	1.20	1.20
	2021年度	8.04%	0.73	0.73
	2022年1-3月	0.73%	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	2019年度	11.55%	0.69	0.69
	2020年度	15.72%	1.10	1.10
	2021年度	7.27%	0.66	0.66
	2022年1-3月	0.58%	0.06	0.06

（五）发行人存在的主要风险

1、经营风险

（1）营业收入、毛利率或净利润下降的风险

受平板显示模组设备领域成熟产品市场竞争加剧、原材料采购价格上涨等经济环境外部因素，以及平板显示模组设备中采用 OEM 方式生产的占比提高、

产品结构变化等内部因素的影响,2021年度公司主营业务毛利率33.00%,较2020年度下降5.42个百分点;同时,受销售人员数量和平均薪酬增长的影响,公司销售费用等增长较快,上述主要因素导致公司2021年度营业收入虽增长40.57%,但净利润下滑9.42%,归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润下滑24.28%。

受新冠疫情对终端产品需求扰动的影响,2021年第一季度平板显示模组业务相对常年同期明显增加,至2022年第一季度收入季节性特点回归常态,加之新冠肺炎反复导致公司深圳生产办公基地封控停产多日、外地售后调试与交付验收亦受到影响,公司营业收入、净利润和归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为16,453.56万元、1,195.78万元和445.75万元,较上年同期分别下降20.19%、51.98%和78.61%,下降幅度较大。

如未来宏观市场环境、显示面板与半导体设备市场景气度、原材料价格、下游客户产品需求等发生重大不利变化且持续时间较长,或者公司未能及时调整经营策略,持续提升销售、研发、管理人员效益比,导致营业收入、毛利率或净利润持续大幅下滑,将对公司持续经营能力产生不利影响。

(2) 获取新订单金额下降的风险

受市场竞争加剧、面板行业周期性波动、半导体行业投资扩张趋势归于常态、疫情扰动以及公司业务战略性调整等因素影响,公司2021年下半年以来各季度新签订单金额低于上年同期,如果公司未能及时采取措施有效应对行业趋势变化,将存在获取订单金额继续下降的风险,进而影响公司的盈利水平。

(3) 市场竞争风险

1) 国内市场竞争加剧的风险

近年来,受益于新兴电子消费行业和半导体行业的飞速发展,国内平板显示产业和半导体产业快速扩张,带动相关设备的市场需求不断扩大,吸引了大量的国内外厂商进入。

在平板显示设备领域,国外厂商凭借其技术先发优势居于全球领先地位,尤其在业务规模、产品多样性、国际市场影响力方面优势明显。国内厂商虽然起步晚,但凭借其优良的性价比和本土优势,在平板显示器件后段制程设备领域发展迅速,且部分同行业可比公司已登陆国内资本市场,在资产规模、业务规模、盈

利水平、融资能力等方面存有一定优势；在半导体设备领域，长期由欧美、日本等国家和地区的国际知名企业主导，它们凭借技术研发和品牌优势，占据了大部分的国内市场份额。近年来随着国家对半导体产业重视和支持力度的持续增加，国内半导体设备企业逐步崛起，在半导体后道制程的部分封装和测试设备方面取得了重要突破，受国内半导体设备国产化预期的影响，未来还将有更多的潜在竞争者加入。

随着行业内企业数量的增加，国内市场的竞争将日趋激烈，如果未来公司不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，将使公司在未来的市场竞争中处于不利地位，进而对业绩增长产生不利影响。

2) 发行人主要产品未来市场空间相对较小的风险

公司主要产品为贴合设备等平板显示器件后段制程设备和测试分选机等半导体后道封测设备，其中**2022年1-3月**平板显示器件后段制程设备和半导体后道封测设备的销售收入占公司营业收入的比例分别为**27.60%**和**48.59%**。平板显示器件新增产线投资具有前段制程设备单次投资额占比大而后段制程设备单次投资额占比小的特点，其中后段制程设备投资占比15%-30%；半导体产线设备投资中，封装测试环节设备占比约为10%。

此外，公司目前并无生产平板显示器件前段制程设备和半导体前道制程设备的相关计划及技术储备，如果未来国内平板显示行业和半导体行业新增设备投资下滑，且现有产线设备的升级改造需求增长乏力，则公司将面临产品销售市场拓展的相关风险，从而会对公司未来经营产生不利影响。

(4) 宏观经济周期波动的风险

目前公司产品的下游应用行业主要为面板生产、消费类电子产品制造及集成电路产品制造等，上述行业与宏观经济发展息息相关，因此宏观经济的走势和景气程度及行业政策的调整将会通过产业链传导对公司的经营产生影响。如境内外宏观经济形势出现较大的波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

(5) 平板显示行业投资下滑的风险

公司平板显示类产品的下游客户多为大型显示面板和模组生产厂商，公司产品的市场需求主要来源于上述厂商的新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造需求。近年来随着平板显示器件应用终端市场的不断扩展，国内显示

面板和模组产能不断扩大，但行业下游需求影响因素较多，如果国家产业政策、贸易环境、境内外经济形势等发生重大不利变化，或者行业技术路径出现颠覆性的演变等，使得显示面板行业的终端需求不及预期，平板显示行业投资下滑，将对公司的经营发展产生不利影响。

（6）收入季节性波动的特点与经营业绩波动的风险

公司客户主要为大型显示面板、模组生产和半导体封测企业，其采购设备的主要影响因素包括资金预算情况、产能扩张的需求以及由于新技术或新产品的出现对原有的设备进行更新换代、升级改造等。一方面，设备采购通常遵循严格的预算管理制度，投资申请、审批主要集中在每年的第四季度，并于次年执行采购，次年下半年完成出货和设备验收。另一方面，智能手机等终端厂商的新品发布周期、排产计划、技术升级迭代与消费者偏好等因素也会带来面板和模组生产企业设备采购需求的变动，进而影响公司销售收入的波动。因此，公司收入具有季节性波动的特点，经营业绩受此影响而存在周期性波动的风险。

（7）新冠肺炎疫情对经营业绩的影响风险

受新冠肺炎疫情爆发因素的影响，2020年以来全球多数国家和地区的经济的发展受到不同程度的影响。疫情对全球经济的影响逐步从生产端向需求端转移，通过产业链传导，将继续对公司的经营带来影响。若新冠肺炎疫情在较长时间内依然不能得到有效控制，并导致终端产品需求持续萎缩、产品升级迭代减慢、投资计划放缓，将对公司经营业绩造成不利影响。

（8）房屋租赁可能产生的风险

发行人及其子公司目前主要生产经营场所（包含办公楼、厂房）系租赁的房产，由于历史原因，上述房产尚未取得相关的产权证书。如出租方在租赁合同的有效期内由于出租房产的产权瑕疵而导致无法继续出租房产，将使本公司及相关子公司的生产场地面临被动搬迁的风险，会对公司一段时间的生产经营造成不利影响。

（9）销售区域集中的风险

受上游厂商区域布局的影响，公司客户主要集中在华东、华南地区，报告期内，两片区的收入贡献率分别为74.62%、69.52%、**61.92%**和**74.86%**，销售区域

比较集中。如未来上述区域的市场竞争进一步加剧，且其他区域市场的业务开发不及预期，公司将面临因销售区域集中产生的业绩下滑风险。

2、技术风险

(1) 核心技术人员流失和技术失密风险

公司所处智能装备行业的技术研发具有多学科交叉的特点，对研发人员综合知识储备及运用能力均有较高要求。如公司主要研发人员无法或不愿留任公司，公司将面临无法及时找到合适人选加以替代的风险，或上述人员加盟竞争对手，将给公司带来技术研发迟缓或技术失密的风险，进而对公司的业务发展造成不利影响。

(2) 研发能力未能匹配客户需求的风险

一方面，公司的下游应用行业普遍具有技术密集、产品更新换代快、技术迭代频繁等特征；另一方面，公司的主要产品具有定制化和非标准化特征，将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的研发能力是公司在行业竞争中胜出的关键。如果公司的设计研发能力和技术储备无法与下游行业的产品需求及技术创新速度相匹配，则公司将面临客户流失风险，进而会对公司的经营发展产生不利影响。

(3) 平板显示行业技术迭代的风险

平板显示技术迭代是行业的常态，其中有目前主流的 TFT-LCD 和 AMOLED 显示技术，也包含近年来涌现的 Mini-LED 和 Micro-LED 等新型显示技术，预计未来将出现多种显示技术长期并存的局面，各种技术仅在不同的终端应用领域出现分化，公司也已有相关的技术储备，但不排除平板显示技术出现颠覆性演进带来的整体技术迭代的风险。在未来平板显示技术演进的过程中，若公司不能正确判断技术、终端应用产品的发展趋势并及时应对，或者持续创新不足导致无法及时跟进行业技术升级迭代，将导致公司产品和技术或存在被替代的风险，从而使公司的经营业绩和盈利能力面临下滑的风险。

3、财务风险

(1) 原材料价格波动对发行人业绩影响较大的风险

公司采购的原材料主要分为 PLC、伺服、工控机、相机等标准通用件和同步轮、输送线、治具等非标定制件两大原材料类。报告期各期，直接材料占主营业务成本的比例在 89%以上，占比较高。一方面，如果主要供应商生产经营突发重大变化，或供货质量、时限未能满足公司要求，或与公司业务关系发生不利变化，公司在短期内将可能面临原材料短缺而影响正常生产经营的风险；另一方面，公司下游客户主要为大型显示面板、功能模组生产、半导体封测厂商，客户分布较为集中、经营规模较大，公司产品占其采购的比例较小、议价能力相对较弱，公司原材料价格上涨难以即时传导到销售端，如果主要原材料市场价格出现大幅增长将对公司产品毛利率产生不利影响。

(2) 应收账款金额较高的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 27,425.90 万元、39,422.69 万元、51,509.47 万元和 53,358.34 万元，最近三年应收账款占各期营业收入的比重分别为 58.11%、60.84%、56.55%，金额占收入比重相对较大。如果由于客户的支付能力和信用恶化导致货款无法按期收回，将对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

(3) 存货管理风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 15,644.57 万元、24,674.74 万元、23,098.46 万元和 22,455.03 万元，占总资产的比例分别为 22.05%、22.62%、15.52%和 15.71%，存货账面价值较大，占比相对较高。2022 年 3 月末的库存商品余额为 6,102.27 万元，其中无订单金额 3,494.54 万元，期末库存商品的订单覆盖率为 42.73%。如果公司因产品生产销售周期过长或销售受阻而造成存货积压并占用营运资金的情况，并对公司经营业绩产生不利影响。

(4) 税收优惠占利润总额比例较高的风险

报告期内，公司享受所得税税收优惠、软件产品增值税即征即退、增值税出口退税等优惠政策，税收优惠以及占当期利润总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
所得税税收优惠	208.19	451.32	646.50	200.11
软件产品增值税实际税负超 3% 部分即征即退的税收优惠	280.85	2,386.33	1,143.44	1,475.88
增值税出口退税	23.58	666.51	206.59	127.05

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
税收优惠合计	512.62	3,504.17	1,996.53	1,803.04
利润总额	1,345.00	7,708.82	8,916.34	5,564.09
税收优惠占利润总额比例	38.11%	45.46%	22.39%	32.41%

公司税收优惠主要来源于嵌入式系统控制软件的增值税实际税负超3%部分即征即退的税收优惠。报告期各期，公司享受的税收优惠总额占当期利润总额的比例分别为32.41%、22.39%、**45.46%**和**38.11%**，占比较高。如果公司未来享受的税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

(5) 财税优惠政策变化的风险

1) 所得税税收优惠

公司于2018年11月9日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201844202589。公司自2018年至2020年，可享受15%的所得税税收优惠缴纳企业所得税。公司于2021年12月23日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR202144200348。公司自2021年至2023年，可享受15%的所得税税收优惠缴纳企业所得税。

线马科技于2017年10月31日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201744201670。线马科技自2017年至2019年，可享受15%的所得税税收优惠缴纳企业所得税。2020年12月11日，线马科技的高新技术企业复审获得通过，证书编号为GR202044202410，2020年至2022年继续享受15%的所得税税收优惠缴纳企业所得税。

深科达半导体于2018年10月16日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201844202134。深科达半导体自2018年至2020年，可享受15%的所得税税收优惠缴纳企业所得税。深科达半导体于2021年12月23日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，

证书编号为 GR202144206557。深科达半导体自 2021 年至 2023 年，可享受 15% 的所得税税收优惠缴纳企业所得税。

深科达微电子于 2021 年 12 月 23 日被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为：GR202144201268。有效期三年，自 2021 年至 2023 年，可享受 15% 的所得税税收优惠缴纳企业所得税。

惠州线马、惠州半导体、惠州微电子、景尚精密、深极致、深卓达和明测科技符合国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（财税[2021]8 号）和财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号）对小微企业的认定标准，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据国家现行的有关产业政策和税收政策以及公司的经营情况，在可预见的未来公司享受的税收优惠将具有可持续性。但若国家未来调整有关高新技术企业的相关优惠政策，将会对公司的经营业绩产生影响。

2) 软件增值税即征即退优惠

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司相关软件销售收入按规定的税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

若未来软件产品增值税即征即退政策变化，公司可能不再享受上述税收优惠政策，将对公司的盈利能力产生不利影响。

4、内控风险

(1) 实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为黄奕宏先生，本次发行前实际控制公司 40.63% 的股份表决权，其中，黄奕宏直接持有公司 16.49% 的股份，其控制的深科达投资持有公司 6.28% 的股份；黄奕宏之哥哥黄奕奋、姐夫肖演加均持有发行人 8.93% 的股份，且黄奕宏与黄奕奋、肖演加于 2020 年 3 月 18 日续签了《一致行动协议》，肖演

加、黄奕奋承诺在决定发行人发展战略、重大经营决策、日常经营活动，特别是行使召集权、提案权、提名权、表决权时与黄奕宏保持一致。因此，如果公司实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其它方式，对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，则可能会损害公司及其他股东利益。

（2）公司快速成长引致的管理风险

近年来，公司业务不断发展，资产规模的扩大、人员的增加都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制、或未能很好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，公司则可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致的风险。

5、与本次募集资金投资项目相关的风险

（1）募集资金投资项目的研发风险

本次募投项目中，Mini/Micro-LED 显示面板涉及的技术尚在发展中，具体来说，Mini-LED 背光显示方案技术相对成熟，有部分产品已实现商业化落地，Mini/Micro-LED 直显方案尚未成熟，也未有成熟的商业化产品落地；相应的，公司 Mini-LED 背光显示屏幕组装设备实现部分销售，但尚未有针对 Mini/Micro-LED 直显屏幕的设备推向市场；半导体先进封装测试设备涉及技术路线虽然在国外已较为成熟，但国内企业在该领域的积累与国外企业尚存在一定差距，具体到本次募投项目规划的产品，划片机、CP 测试机等产品尚处于研制阶段。总体上，本次募投项目规划的新产品还需要一定的资金支持和技术积累。如果公司相关产品研发失败、新产品不能如期开发成功或产业化后不能符合市场需求，将对公司的竞争优势和经营业绩造成不利影响。

（2）募集资金投资项目建设及实施的风险

本次募集资金投资项目的实施计划和实施进度系依据发行人及行业的过往经验制定，经济效益数据系依据可研报告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出。若项目在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进度建成，或项目建成后的市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品

价格下滑、产品市场需求未保持同步协调发展，将可能导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平。

（3）新增固定资产折旧的风险

根据发行人本次募集资金投资项目规划，项目建成后，公司固定资产规模将出现较大幅度增加，相应的年折旧费用也将增加。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增固定资产折旧的影响，但由于影响募集资金投资项目效益实现的因素较多，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化，导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，则新增固定资产折旧将对发行人未来的盈利情况产生不利的影

（4）募集资金投资项目管理风险

随着本次募投项目的实施，公司资产规模、经营规模将逐步扩大，相应的研发、销售及管理人员数量**总体呈上升趋势**，在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司管理水平提出更高的要求。公司如果不能有效的进行组织结构调整，进一步完善管理流程和内部控制制度，**提升人员效益比**，将影响公司的应变能力和市场竞争力，使公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

（6）产能消化风险

公司募投项目的产能设计综合考虑了行业与市场的发展情况、潜在客户的需求状况、公司产品或服务的竞争优势、公司产品研发计划以及公司的销售策略等因素，但本次募投项目新增的产能仍然受市场供求关系、行业竞争状况和技术发展等多层次因素的影响。未来，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目每年将新增 66 台/套 Mini/Micro-LED 显示模组组装和检测设备的产能，半导体先进封装测试设备研发及生产项目每年将新增 360 台半导体封测设备的产能，另外每年还需承接惠州深科达平板显示器件自动化专用设备生产建设项目规划的 380 台/套平板显示模组类设备的部分新增产能。

截至本上市保荐书签署日，惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目和半导体先进封装测试设备研发及生产项目规划相关产品中仅有 Mini-LED 背光显示相关设备、适用传统封装的半导体固晶机、AOI 芯片检测设备实现了销售，且销售和在手订单金额相对较小；其余 Mini/Micro-LED 直显相关设备、

划片机、CP 测试机等产品尚处于研制阶段，未有实现销售、存有在手订单或与客户达成合作意向的情况。

在上述募投项目实施过程中，若行业发展和市场需求不及预期、行业竞争加剧、行业技术路线发生重大不利变化、公司技术研发计划受阻或产品优势不足导致下游客户及市场认可度不够等，将会导致募投项目市场开拓不及预期，进而存在新增产能消化的风险。

6、与本次可转债发行相关的风险

（1）不符合投资者适当性要求的持有人所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，参与转股的本次可转债持有人应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

（2）可转债的本息偿还风险

若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力可能恶化，造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者可能将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。

（3）可转债在转股期内未能转股的风险

对于投资者而言，公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，转股期内，股票价格存在由于各方面因素的影响而不能达到或者超过本次可转债转股价格的可能性，将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若本次可转债达到赎回条件且公司行使相关权利进行赎回，将会导致投资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入减少。

对于公司而言，如因公司股票价格低迷或未达到可转债持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

（4）可转债交易价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动，从而影响投资者的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

（5）转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次可转债发行后，如果可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将有一定程度增加，但本次可转债募投项目从投入到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度的情况，从而存在摊薄即期每股收益和净资产收益率的风险。

（6）可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险

公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来在触发转股价格向下修正的条件时，公司董事会基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，可能不提出转股价格向下修正方案；或董事会虽提出转股价格向下修正方案，但方案未能通过股东大会表决，从而未能实施。因此，本次可转债存续期内，持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。此外，发行人董事会将综合考虑公司的经营情况、股价走势、市场环境等因素确定转股价格向下调整方案，因此在实施向下修正条款的情况下，转股价格向下修正幅度也存在不确定性。

（7）可转债存续期内转股价格向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险

本次可转债存续期内，若触发转股价格向下调整的条件，本次可转债的转股价格可能向下调整，同等规模可转债的转股数量也将相应增加，从而导致原有股

东股本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。

（8）可转债投资者不能实现及时回售的风险

本次可转债约定了有条件回售条款：本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

由于影响股票价格的因素复杂多变，如果在可转债存续期内公司股价持续低于当期转股价格 70%，但未能满足约定的其他回售必备条件时，投资者将面临无法行使可转债回售权的风险。

（9）可转债提前赎回的风险

本次可转债设有有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

本次可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（10）可转债转换价值降低的风险

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者

即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

（11）可转债评级风险

根据中证鹏元出具的中鹏信评【2021】第 Z【1499】号 02《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+，公司主体信用等级为 A+。在本次可转债存续期内，如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，有可能会导导致公司的主体评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本次债券投资者的利益受到不利影响。

（12）可转债未担保风险

本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

二、本次发行情况

本次发行的具体方案如下：

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的类型为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 36,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ 。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

(八) 转股价格调整的原则及方式

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$\text{派送股票股利或转增股本： } P_1 = P_0 / (1 + n) ;$$

$$\text{增发新股或配股： } P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

$$\text{上述两项同时进行： } P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k) ;$$

$$\text{派送现金股利： } P_1 = P_0 - D ;$$

$$\text{上述三项同时进行： } P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k) 。$$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股数不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$ 。

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

（十三）转股后的利润分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
- （3）根据约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司关于本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 拟变更债券募集说明书的约定；
- (2) 拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
- (4) 公司不能按期支付本息；

(5) 公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

- (6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (7) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

(8) 公司、单独或合计持有本次债券总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；

(9) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

- (10) 公司提出债务重组方案的；
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

(12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；
- (2) 债券受托管理人；

(3) 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(十七) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 36,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	子项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	深科达智能制造创新示范基地续建工程	惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	15,504.83	11,766.50
2		半导体先进封装测试设备研发及生产项目	12,521.87	8,925.59
3	深科达智能制造创新示范基地	平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	25,807.94	5,307.91
4	补充流动资金	/	10,000.00	10,000.00
合计			63,834.64	36,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于本次拟使用募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

(十八) 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

(十九) 募集资金存管

本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户(即募集资金专户)中，具体开户事宜在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定。

（二十）评级事项

根据中证鹏元出具的中鹏信评【2021】第 Z【1499】号 02《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+，公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、保荐机构及其人员情况

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人

1、韩志广先生：安信证券投行部执行总经理、保荐代表人，武汉大学金融工程硕士、理学与经济学双学士。负责或参与的项目包括：深科达 IPO、玲珑轮胎 IPO、中泰证券 IPO、玲珑轮胎可转债及公开增发、国泰君安可转债及 16 公司债、文登城资 11 公司债、云南城投非公开发行、西北轴承收购财务顾问、天兴仪表重大资产重组等。

2、赵跃先生：安信证券投行部业务副总裁、保荐代表人、非执业律师，武汉大学经济学硕士。曾参与国泰君安可转债、深科达 IPO、玲珑轮胎可转债、玲珑轮胎公开增发等项目，同时也负责和参与过多家拟上市公司的资产重组和股份制改造工作。

（二）项目组其他成员

项目组其他成员：沙春选、李卓群、邹静姝、雷舟。

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要

业务往来情况

安信证券作为发行人本次发行的保荐机构，自查后确认本保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》及《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定，安信证券另类投资子公司安信证券投资有限公司使用自有资金参与深科达首次公开发行股票的战略配售，截至 2022 年 3 月 31 日，持有发行人 994,600 股，占发行人总股本的 1.23%。同时，截至 2021 年 9 月 30 日，安信证券资管产品业务股票账户持有发行人 872,567 股，占发行人总股本的 1.07%。该等情形不会影响保荐机构公正履行保荐职责。

除此之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人及重要关联方与发行人控股股东、实际控制人及重要关联方不存在相互提供担保或融资等情况。

（五）本保荐机构与发行人不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

（一）本保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）本保荐机构同意推荐深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，上述结论具备相应的保荐工作底稿支持。

（三）根据《保荐管理办法》第二十六条的规定，本保荐机构承诺如下：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上交所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会、上交所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会、上交所依照《保荐管理办法》采取的监管措施。

（四）本保荐机构承诺，自愿按照《保荐管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

（五）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

六、本次证券发行上市履行的决策程序

发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：

（一）2021年10月22日，发行人召开了第三届董事会第十二次会议，该次会议应到董事5名，实际出席董事5名，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

（二）2021年10月22日，发行人召开了第三届监事会第八次会议，该次会议应到监事3名，实际出席监事3名，审议通过了《关于公司符合向不特定对

象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

（三）2021年11月8日，发行人召开了2021年第二次临时股东大会，出席会议股东及股东代表持股总数40,847,385股，占发行人股本总额的50.40%，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

发行人律师出具了《广东华商律师事务所关于深圳市深科达智能装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

综上所述，本保荐机构认为，发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及上交所规定的决策程序；发行人本次发行的申请尚需获得上交所审核通过以及中国证监会作出同意注册的决定。

七、保荐机构关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见

公司是一家智能装备制造制造商，主要从事平板显示器件、半导体封测、摄像头等领域的专用设备的研发、设计、生产和销售。公司所处的智能装备行业是国家鼓励发展的高新技术产业和战略新兴产业，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条第二款的规定。

“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”旨在研制Mini/Micro-LED专用组装和检测设备，是公司针对平板显示行业新技术和下游市场新需求而拓展的新业务。该项目的实施，将进一步提升公司在图像识别、压力精密控制、高精度贴合等方面的技术优势，丰富公司在平板显示器件生产设备领域的产品结构，巩固和扩大该领域的市场份额。

“半导体先进封装测试设备研发及生产项目”是公司顺应半导体产业国产化趋势的重要战略举措，公司将依托多年来在测试机和分选机研制过程中积累的技术优势，针对先进封装工艺特性进行技术研发，向市场推出符合半导体先进封装需求的高性能封装和测试设备。该项目的实施，有利于提升公司对关键核心技术

的攻关能力，有利于拓宽公司半导体封测设备下游应用领域，有利于实现产品的多元化布局，为公司找到新的利润增长点，降低经营风险，从而实现可持续发展。

“平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”系围绕柔性 OLED 和中大尺寸 LCD 平板显示器件自动化专业设备两个重点领域展开，公司目前已有相对成熟的量产设备。该项目的建成能够扩大公司现有平板显示器件组装及检测设备产能，进一步加强公司在该领域的先发优势，完善技术储备库，提升应对行业技术迭代风险的能力。

“补充流动资金”亦将用于满足公司未来主营业务发展的资金需求。

因而，本次募集资金投向与公司现有业务的技术、生产工艺、产业链、市场具有高度的相关性，是对现有主营业务的补充、拓展和优化；通过本次募投项目的实施，公司整体研发水平将进一步增强，研发条件、实验设备、研发创新团队将获得发展与壮大，公司的自主创新优势、技术水平优势将进一步强化，有助于提升公司的核心竞争力，亦有助于推动我国智能装备行业的发展，是公司实现战略发展目标的重要举措。

综上所述，保荐机构认为：公司本次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定的要求。

八、保荐机构对公司持续督导工作的安排

发行人本次发行的可转债上市后，本保荐机构及保荐代表人将根据《保荐管理办法》和中国证监会、上交所的相关规定，尽职尽责完成持续督导工作。

主要事项	具体计划
(一) 持续督导事项	证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度

主要事项	具体计划
<p>1、督促发行人建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度</p>	<p>(1) 协助和督促发行人建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和《上市规则》的要求，并确保发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在《上市规则》下的各项义务。</p> <p>(2) 持续督促发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>(3) 对发行人制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。</p> <p>(4) 督促发行人控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p> <p>(5) 发行人或其控股股东、实际控制人作出承诺的，督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露；持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。披露、履行或者变更承诺事项不符合法律法规、《上市规则》以及上交所其他规定的，及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p> <p>(6) 督促发行人积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。</p>
<p>2、识别并督促发行人披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见</p>	<p>(1) 持续关注发行人运作，对发行人及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注发行人日常经营和股票交易情况，有效识别并督促发行人披露重大风险或者重大负面事项。</p> <p>(2) 核实发行人重大风险披露是否真实、准确、完整，并于发行人披露公告时，就信息披露是否真实、准确、完整等发表意见并披露。</p>
<p>3、关注发行人股票交易异常波动情况，督促发行人按照《上市规则》规定履行核查、信息披露等义务</p>	<p>发行人股票交易出现严重异常波动的，督促发行人及时按照《上市规则》履行信息披露义务。</p>
<p>4、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺</p>	<p>关注控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员减持发行人股份是否合规、对发行人的影响等情况。</p>
<p>5、关注发行人使用募集资金的情况</p>	<p>督促发行人合理使用募集资金并持续披露使用情况。</p>

主要事项	具体计划
6、对发行人存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查，就核查情况、提请发行人及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露。
7、定期出具并披露持续督导跟踪报告	在发行人年度报告、半年度报告披露之日起 15 个交易日内，披露持续督导跟踪报告。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 对发行人进行定期走访、定期和不定期查验；(2) 派出人员列席发行人的董事会、监事会和股东大会；(3) 派出人员参加发行人的总经理办公会或其他会议和活动；(4) 查阅发行人的会议纪录、财务资料及其他有关文件；(5) 与发行人指定人员和相关中介机构人员进行日常沟通；(6) 向发行人提出持续督导工作询问函。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	(1) 保荐机构可以在发行人公告季度、半年度或年度报告公告前，派出人员对发行人进行实地走访，查验、分析发行人生产经营情况、财务状况、规范运作、履行承诺、信息披露等情况；(2) 保荐机构若发现发行人存在问题或异常情况的，有权对存在的问题和异常情形进行尽职调查并提出整改意见，要求发行人限期整改或报告，发行人应对保荐机构的工作给予充分配合，并按照保荐机构整改建议要求的内容和期限进行整改；(3) 保荐机构有权对发行人在持续督导期间内发生的关联交易进行尽职调查，收集关联交易有关资料；(4) 保荐机构若对发行人的重大事项或重大风险隐患有疑义，可以聘请中介机构对有关事项进行专项核查，发行人应对保荐机构和有关中介机构的工作给予充分配合；(5) 保荐机构指派的保荐代表人对发行人信息披露文件及时进行审阅。(6) 保荐机构对持续督导期间内律师事务所、会计师事务所等中介机构出具意见存在疑义的，有权直接或者通过发行人与上述中介机构签字人员及时沟通，发行人应给予充分配合。
(四) 其他安排	无。

九、保荐机构对发行人发行的可转债上市的保荐结论

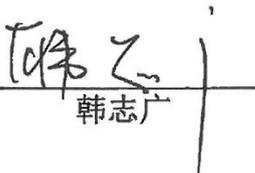
本保荐机构认为，发行人申请其本次发行的可转债上市符合《公司法》《证券法》《保荐管理办法》《注册管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规和中国证监会、上交所有关规定，发行人本次发行的可转债具备在上交所上市的条件。本保荐机构同意推荐发行人本次发行的可转债上市交易，并承担相关保荐责任。

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人:


沙春选

保荐代表人:

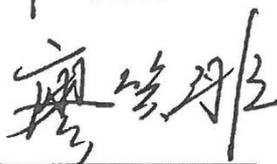

韩志凡


赵跃

内核负责人:


许春海

保荐业务负责人:


廖笑非

法定代表人、董事长:


黄炎勋



安信证券股份有限公司
2022年5月5日